

无锡芯朋微电子股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“芯朋微”）于 2025 年 3 月 27 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2025 年 8 月 15 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

2026 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升产品核心竞争力

公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向，专注于为客户提供电源和电机系统芯片及解决方案。公司主要产品为高可靠性电源管理芯片、功率器件以及各类驱动产品，主要品类包括 AC-DC 电源产品线、DC-DC 电源产品线、Digital PMIC 电源产品线、驱动产品线、功率器件产品线和功率模块产品线等六大类，目前有效的产品型号超 2,000 款，全面覆盖服务器电源、通信、光伏/储能/充电桩、智能电网、工业电机、智能家电、智能终端的充电器适配器等众多领域。

2025 年，公司持续推进新产品线拓展，扩大下游行业应用范围。公司新品类产品（DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）营收同比大幅增长 39%，其中服务器应用领域营收同比增长超 4 倍。2025 年，公司重磅推出 12 款面向 AI 计算能源领域的核心新品，首家完成服务器一次电源、二次电源到三次电源的全链路布局，其中面向 800V HVDC 系统的 1700V SiC 辅源、隔离驱动、SiC/GaN 驱动等芯片、兆赫兹开环 DCX 控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16 多相 VRM、70/90A Cu-Clip DrMOS、eFuse、PoL 等高性

能功率产品可满足高算力服务器对电源转换效率、稳定性及小型化的要求。2025年公司推出了多个系列的创新性电源和电机的功率模块，营收同比增长1.9倍，包括集成电感的CubeSiP专利技术的DC-DC电源模块、内置高压半桥驱动和保护保护的电机驱动模块以及集成SiC器件和半桥电机驱动模块，公司核心技术正在从硅基芯片级高集成技术，延展至涵盖宽禁带器件异质集成和全维封装的系统级高集成技术领域。

2026年，公司将持续深耕“电源和电机功率系统芯片及解决方案”战略，目前已基于五大核心技术（高低压集成工艺、智能功率器件、数模混合功率设计、多学科失效分析、高密度功率封装）构筑出六大具备协同效应的产品线（AC-DC、DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）架构。目前公司在高低压集成半导体技术领域处于行业领先地位，公司将通过持续创新的高效能、高集成及高可靠的智能化产品与技术，未来三年，基于全面升级的Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaN的全新智能功率芯片技术平台、多相数字技术平台和DrMOS特殊工艺技术平台，满足终端整机系统不断升级的能源挑战，以先进芯片驾驭电能，把智慧能源普惠到每个人。

二、持续完善投资者回报机制

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将利润分配政策写入公司章程，在兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。自2020年在上海证券交易所科创板上市以来，公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

（一）截至2025年12月31日，公司共计现金分红20,034.31万元；公司实施3次股份回购，回购金额为19,834.09万元。分红回购金额合计39,868.40万元，占2025年归属于上市公司股东净利润总额的214%。

（二）2025年度利润分配预案，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每10股派发现金红利4.50元，合计拟派发现金红利约5,807.33万元（含税）。公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

三、持续加强募投项目管理，提升科技创新能力

2022年3月，公司披露了定增预案，募集资金将用于“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”和苏州研发中心的建设、实施。

近三年来公司重点投入研发的工业应用领域，随着拳头产品“高耐压高可靠AC-DC”在大多数工业客户取得大面积突破和量产，公司跟进推出适用于服务器和通信设备的48V输入数模混合高集成电源芯片系列和内置算法的数模混合电机驱动芯片、超大电流EFUSE芯片、超大功率理想二极管芯片等大功率工控芯片，2025年新兴工业市场（服务器/通信/工业电机/光储充/新能源车）营业收入同比大幅提升50%以上。

2026年，公司将继续推进“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”和苏州研发中心的建设、实施；同时，持续加强募集资金管理规定，审慎使用募集资金，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

四、完善公司治理结构

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，全面修订公司章程及配套制度，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，并完成职工董事选举，确保公司顺利完成治理架构的调整。公司将密切关注法律法规和监管政策的调整，持续更新完善公司内部管理制度，提升规范运作水平和风险防控能力。

2025年，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责。董事、高级管理人员积极参与了“市值管理专题培训”、“独立董事后续培训”、“独立董事履职学习平台”、“上市公司董事会秘书后续培训”、“上市公司高质量发展暨监管工作系列培训会”等上交所、证监局等监管机构举办的培训，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

2026年，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部

管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任

公司自 2020 年在上海证券交易所科创板上市至今，先后实施了 4 次限制性股票激励计划、1 次员工持股计划的股权激励措施。2025 年，根据 2024 年已审财务数据，公司已达成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期业绩考核指标，并于 2025 年 4 月完成首次授予第一个归属期的归属工作。同时，公司根据已审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以上对于提高激励对象积极性及保持核心团队稳定性有积极的促进作用，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

2026 年，公司将延续 2025 年度的 KPI 考核方式，除短期财务目标外，提升非财务、长期目标及持续学习项目的权重，高管薪酬与 KPI 考核强关联，KPI 考核与公司长远发展和股东利益相结合，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。同时，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。

六、提升信披质量，加强与投资者的沟通

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 E 互动、分析师会议及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。2025 年，公司举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，

通过线上线下等方式，累计接待 240 余人次家券商、机构及个人的调研沟通或电话沟通。通过多种形式，加强与广大投资者的沟通，提高公司在资本市场的开放性，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况、发展现状等，增强投资者对公司的信心，努力夯实资本市场高质量发展基础。

2026 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。在每个财务季度结束后，举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；进行线上路演，利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2026 年公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于 3 次业绩说明会或投资者接待日，不少于 30 次的投资者调研活动等。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日